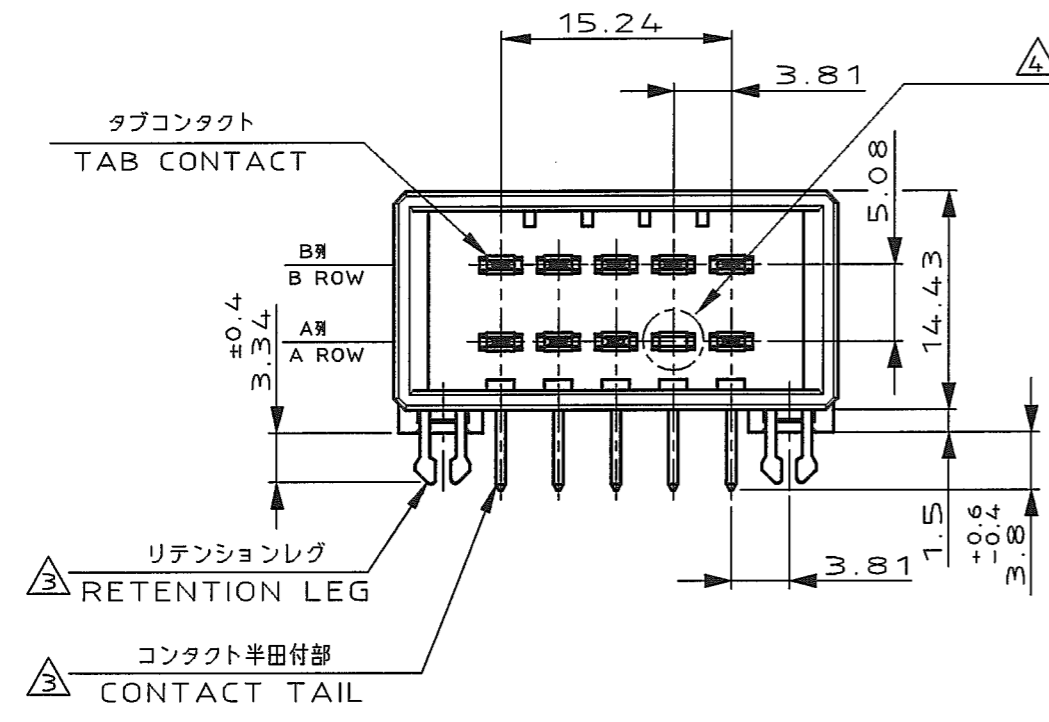
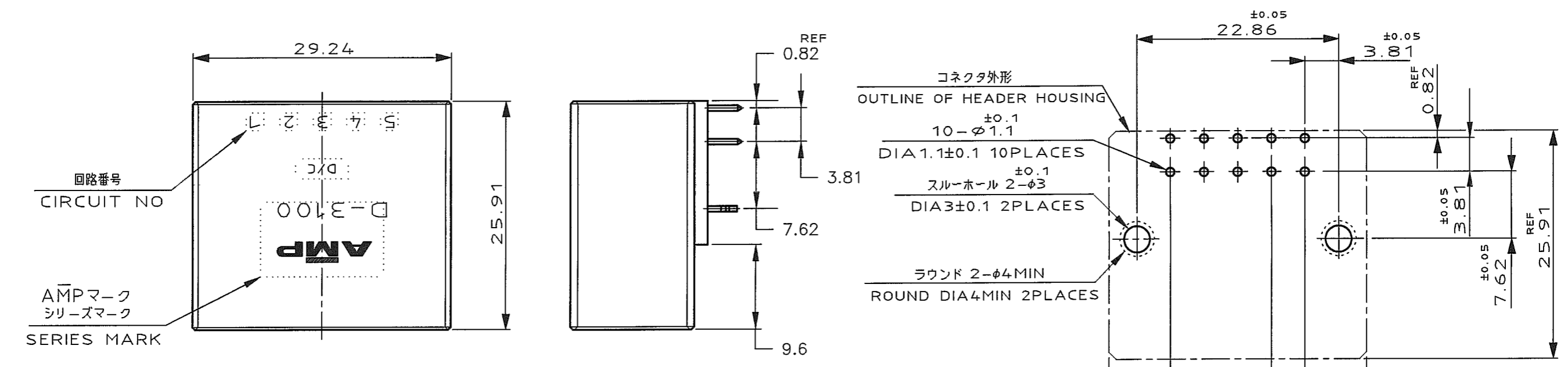


NUMBER 179613
 METRIC
 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)



推奨基板取付け穴寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- 1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- 2. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- 3. FINISH (RETENTION LEG) (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 4. CURCUIT NO. 4 OF A ROW: EMPTY

注記

- 1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
 ポリエステル樹脂
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
- 2. めっき: コネクタ: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- 3. めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
 : ニッケル下地の上にスズめっき
- 4. A 列の4番は空にする。

△3 △2	179613-5
(FINISH)	製品番号 (PART NO.)

A	REVISED (FJD0-0114-03)	T.S.S.M	4/25/94
O	RELEASED (FJ00-0084-94)	K.S.M	2/FEB/94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE

Copyright ©1994年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
結合線径(WIRE RANGE)	絶縁外径(INSULATION DIA.)	材料(MATERIAL)	仕上(FINISH)
mm ² (AWG -)	mm ²	注記参照 SEE NOTE	注記参照 SEE NOTE
DR. 28/JAN/94 K.IKEDA	DE. 28/JAN/94 K.IKEDA	CHK. 2/FEB/94 S.MANABE	APP. 2/FEB/94 S.MANABE

Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
10 POS DOUBLE ROW WITHOUT 1 POS HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100		Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		名称 (NAME)	
10mm以下: ±0.35	10mm以上30mm以下: ±0.4	10 POS DOUBLE ROW WITHOUT 1 POS HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
30mm以上100mm以下: ±0.45	角公差: ±3'	LOC 番号 (No.)	
尺度 (SCALE) 2-1		REV. A	
SHEET 1 OF 1		C=179613	